



特色

- ▶ 最低导通阻抗
- ▶ 电流能力 (300A)
- ▶ 低封装寄生与电感效应
- ▶ 减少并联冷却的需求
- ▶ 系统成本降低
- ▶ 紧凑型设计

全新开发

- ▶ 并排双晶粒能力
- ▶ 双面外露式焊盘以优化热性能
- ▶ 窄线宽薄片晶圆切割
- ▶ 更大/更高密度的引脚框架条带
- ▶ 环境友好的无铅焊膏
- ▶ 铝线互连

TOLL

TOLL (TO-无引脚) 封装能够高效节约空间, 它为电流高达 300A 的汽车应用而量身定制。

- ▶ 该封装的特性
 - ▷ 非常低的寄生和电感效应, 具有世界一流的导通阻抗
 - ▷ 出色的 EMI 表现和热性能
 - ▷ 空间节省: 与 7 LD DPAK 封装相比, 布局缩减 30%, 厚度只有其 50%
 - ▷ 封装拥有可润湿侧翼, 适用于汽车市场
 - ▷ 该封装是一种注册的 JEDEC 封装外形

应用

TOLL 适用于大功率应用, 且专为低导通电阻和高速切换式 MOSFET 而量身定制。

- ▶ 汽车
- ▶ 电信
- ▶ 负载点 (POL) 电源
- ▶ 轻型电动汽车 (LEV)
- ▶ 电池管理

可靠性鉴定

- ▶ 全部可靠性测试包括 JSTD-020 湿度预处理, 高温储存除外
- ▶ 湿度敏感性特性: JEDEC 级别 1, 85°C/85% 相对湿度, 168 个小时, IR 回流焊 260°C 3X
- ▶ uHAST: 130°C/85% 相对湿度、无偏置、96 小时
- ▶ 温度循环: -65~150°C、500 次循环
- ▶ 高温储存: 150°C、1000 个小时

测试服务

Amkor 为全部功率分立产品提供完全一站式的服务。我们有能力测试各种类型的功率器件, 包括 MOSFET、双极型晶体管、IGBT、二极管和稳压器 IC/智能化电源器件。

- ▶ Amkor 的功率分立器件测试能力
 - ▷ 静态测试 (直流)
 - ▷ 动态测试 (交流、开关/Trr、电容/Rg)
 - ▷ 破坏测试 (电感负载/VSUS)
 - ▷ 热阻 (ΔVDS 、 ΔmV , 等等)
- ▶ 程序生成/转换
- ▶ 故障分析
- ▶ 可用的测试/处理技术
- ▶ 集成打标、外观检查和卷带式包装服务

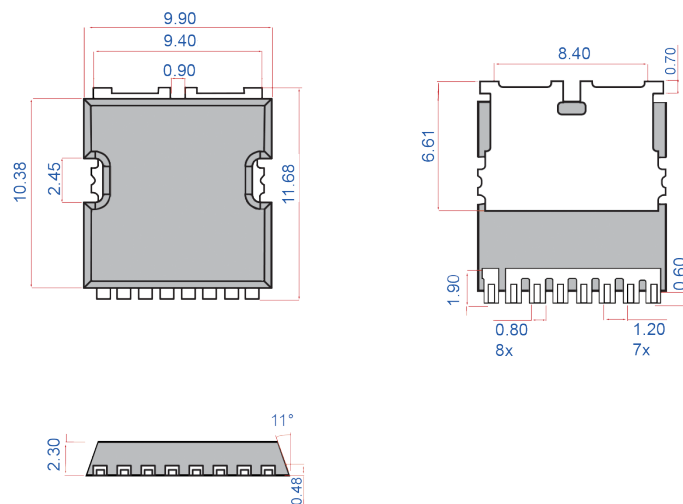
标准材料

- ▶ 引脚框架：裸铜
- ▶ 晶粒贴装：焊膏
- ▶ 互连（3 种选项）
 - ▷ 铜片
 - ▷ 铜片+铜线
 - ▷ 多铜线
 - ▷ 多铝线（正在开发）
- ▶ 模塑化合物：无卤素

装运

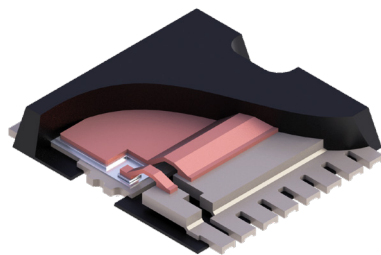
- ▶ 卷带式包装
 - ▷ 每卷 1800 件
 - ▷ 卷带宽度 24 毫米
 - ▷ 每卷直径 = 330 毫米
- ▶ 条形码封装标签
- ▶ 直接代发货

封装外形图

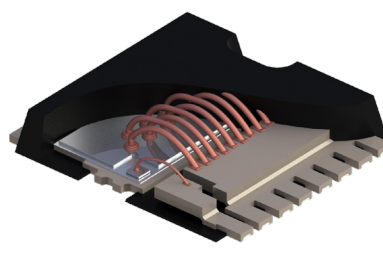


横截面

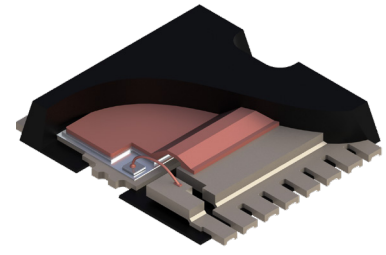
铜片



多铜线



铜片和铜线



访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。

关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2021 Amkor Technology, Incorporated. 保留所有权利。DS618D-CN 修改日期：02/21

